



PRODUCT SPECIFICATION

LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH**【1. 適用範囲 SCOPE】**

本仕様書は、_____ 殿 に納入する

0.35 mm ピッチ 基板対基板用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 0.35mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
リセプタクル ハウジング アッセンブリ Receptacle Housing Assembly	505066-**09
505066-**09 エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505066-**09	505066-**20
プラグ ハウジング アッセンブリ Plug Housing Assembly	505070-**39
505070-**39 エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505070-**39	505070-**40

REV.	0	A	B																
SHEET	1-17	1-17	1-17																
REVISE ON PC ONLY				TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP															
B	REVISED '16/02/17 TSOMEYA			PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書															
	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																		
REV.	DESCRIPTION			DATE: 2016/02/17															
DESIGN CONTROL J			STATUS	WRITTEN BY: STERUKI	CHECKED BY: K.TANAKA03	APPROVED BY: K.MORIKAWA													
DOCUMENT NUMBER 5050660000				DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL			SHEET 1 OF 17										
EN-127(2015-12)																			

【3. 定 格 RATINGS】

項 目 Item	規 格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	50 V	[AC (実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	Terminal 0.3 A / PIN ^{*1} Fitting nail 3.0 A / PIN	
使用温度範囲 ^{*2} Operating Temperature Range ^{*2}	-40°C ~ +85°C ^{*3}	
保管条件 Storage Condition	温度 Temperature	-10°C ~ +50°C
	湿度 Humidity	85%R.H.以下 (但し結露しないこと) 85%R.H. MAX. (No Condensation)
	期間 Terms	出荷後6ヶ月 (未開封の場合) For 6 months after shipping (unopened package)

*1 : 最大許容電流0.3Aでの使用は最大50極までとする。
但し、50極以上の総電流は各極を合計し、15A以下で使用する。こと。
0.3A MAX./PIN is to applied to 50pins MAX.
A total of 15A MAX. is to be applied to over 50 pins.

*2 : 基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.

*3 : 通電による温度上昇分を含む。
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.

REVISE ON PC ONLY	TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
		REV.	DESCRIPTION	
DOCUMENT NUMBER 5050660000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 2 OF 17

【4. 性能 PERFORMANCE】

特別に指定がない限り、測定は以下の条件にて行われること。
Unless otherwise specified, the measurements/tests shall be conducted under the following condition.

Ambient temperature range : 15°C~35°C
Humidity range : 25%~85%
Air pressure : 86kPa~106kPa

但し判定に疑義を生じた場合は、以下の条件にて測定を行う。
However, any question arising out of the result, the measurements/tests shall be re-conducted under the following condition.

Ambient temperature range : 20±1°C
Humidity range : 63%~67%
Air pressure : 86kPa~106kPa

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。(JIS C5402 5.4) Mate connectors and measure contact resistance at less than 20mV of open circuit voltage and less than 10mA of short circuit current.(JIS C5402 5.4)	For Terminal : 80 milliohm MAX. For Nail : 30 milliohm MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間、及びターミナル-ネイル間にDC 250Vを印加し測定する。(JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors and measure insulation resistance at 250V-DC applied to between terminals and terminal-nail that are adjacent. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 mega ohm MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間、及びターミナル-ネイル間にAC(RMS) 250V(実効値)を1分間印加する。(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors and apply 250V-AC (RMS) to between the terminals and terminal-nail that are adjacent for 1 minute. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
4-1-4	温度上昇 Temperature Rise	最大許容電流を嵌合されたコネクタに通電し、温度上昇分を測定する。(UL 498) Apply maximum rated current to the mated connectors and measure the temperature rise.(UL 498)	30 °C MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP	
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書	
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION		

DOCUMENT NUMBER 5050660000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 3 OF 17
--------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	1分間 5回以下 の速さで挿入、抜去を行う。 Conduct insert and withdrawal at the speed of less than 5 cycles per minute.	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引っ張る。 Pull out the terminals assembled to the housing at the speed of 25±3mm per minute.	0.15N {0.015 kgf} Min

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeatedly Insertion / Withdrawal	1分間 5回以下の速さで挿入、抜去を 30回 繰返す。 Repeatedly conduct insert and withdrawal up to 30 cycles at the speed of less than 5 cycles per minute.	接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-2	耐 振 動 性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む 互いに垂直な 3方向 に掃引割合10~ 55~10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動 を 各2時間 加える。(MIL-STD-202 試験法 201) With energizing 1mA-DC to mated connectors, vibrate for 2 hours each in 3 mutually perpendicular planes with the following conditions; 1.5mm of amplitude, 10~55~10 Hz in 1 minute of sweep time. (MIL-STD-202 Method 201)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 micro sec. MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書
B	SEE SHEET 1 OF 17	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER 5050660000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 4 OF 17
-------------------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-3	耐 衝 撃 性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s ² { 50G } の衝撃を作用時間11ミリ秒で各3回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) With energizing 1mA-DC to mated connectors, give 3 shocks each of 490m/s ² { 50G } in 6 mutually perpendicular planes at duration of 11milliseconds. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 micro sec. MAX.
4-3-4	耐 熱 性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to the atmosphere of 85±2°C for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-5	耐 寒 性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate connectors and expose to the atmosphere of -40±3°C for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書
B	SEE SHEET 1 OF 17	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER 5050660000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 5 OF 17
-------------------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-6	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2°C、相対湿度 90~95% の雰囲気中に96時間 放置後、取り出し1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to the atmosphere of the condition; 60±2°C, 90%~95% for 96 hours, then expose to the room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項を満足すること Must meet 4-1-3
			絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	50 Mega ohm MIN.
4-3-7	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55°Cに30分、+85°Cに30分これを1サイクルとし、5サイクル繰返す。 但し、温度移行時間は5分以内とする。 試験後1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-14) Mate connectors and expose to the test atmosphere for 5 cycles; 1 cycle is - 55°C for 30 minutes and + 85°C for 30 minutes. Temperature transfer time should be less than 5 minutes. Then expose to room ambient for 1~2 hours. (JIS C60068-2-14)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書
B	SEE SHEET 1 OF 17	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER 5050660000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 6 OF 17
-------------------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-8	塩 水 噴 霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 5±1% 重量比 の塩水を 48±4時間 噴 霧し、試験後常温で水洗いした後、室 温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験 法 101) Mate connectors and expose to the salt spray atmosphere from the 5±1% solution at 35±2°C for 48±4 hours, then expose to room ambient for dry after water washed connectors. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-9	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 Mate connectors and expose to SO ₂ gas atmosphere of 50±5ppm at 40±2°C for 24 hours.	外 観 Appearance	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

B

SEE SHEET 1 OF 17

TITLE:

0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP

PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
5050660000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
003

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
7 OF 17

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-10	半田付け性 Solder ability	ターミナルをフラックスに浸し、 245±5°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Dip the terminal in flux, then dip it in flux at 245±5°C for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wettability	浸漬した金めっき 面積の95%以上 More than 95% of immersed gold plated area must show no voids or pin holes.
4-3-11	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<リフロー時> 第7項の条件にて、2回リフローを行 う。 <For reflow soldering> Conduct the reflow twice under the condition specified in the paragraph 7.	外 観 Appearance	製品機能を損なう異 状なきこと No damage on function.
		<手半田> 端子および金具の半田付け部を 350±10°Cの半田ゴテにて最大5秒加熱 する。 <For hand soldering> Apply soldering iron heated to 350±10°C to the soldering tail of terminal or nail for a maximum of 5 seconds.		

() :参考規格 Reference Standard

{ } :参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP			
	REV.	DESCRIPTION	PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書		
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 8 OF 17

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

ELV 及び RoHS適合品 ELV AND RoHS COMPLIANT.

【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION/WITHDRAWAL FORCE】

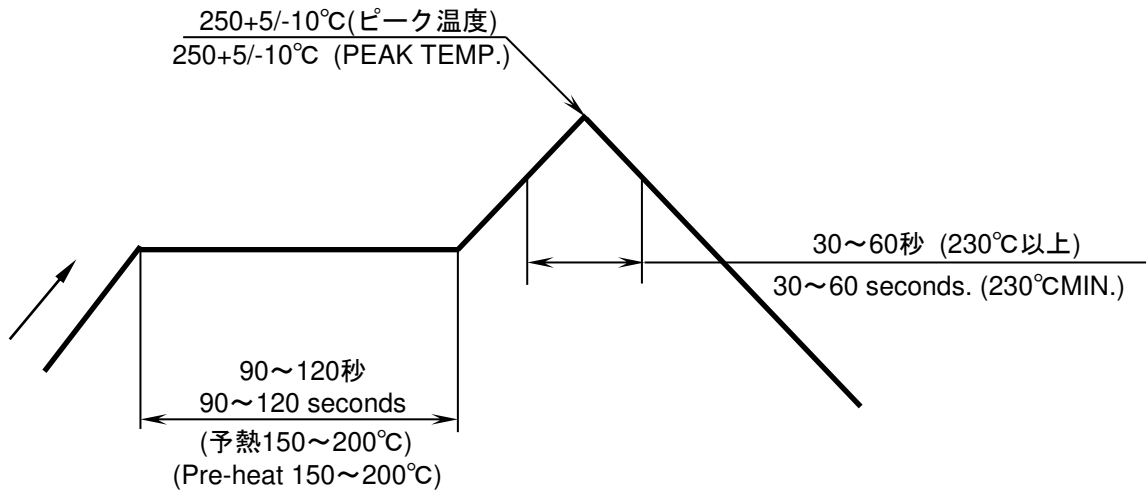
極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力 (最大値) Insertion (MAX.)			抜去力 (最小値) Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
6	N {kgf}	25.0 {2.55}			1.9 {0.19}		
10	N {kgf}	34.0 {2.55}			2.1 {0.19}		
12	N {kgf}	38.0 {3.87}			2.1 {0.22}		
14	N {kgf}	42.5 {4.33}			2.4 {0.24}		
16	N {kgf}	46.5 {4.74}			2.5 {0.26}		
20	N {kgf}	48.0 {4.90}			2.8 {0.29}		
22	N {kgf}	48.6 {4.96}			2.9 {0.30}		
24	N {kgf}	49.5 {5.05}			3.0 {0.31}		
30	N {kgf}	51.5 {5.25}			3.5 {0.35}		
34	N {kgf}	53.0 {5.41}			3.7 {0.38}		
40	N {kgf}	55.0 {5.61}			4.1 {0.42}		
42	N {kgf}	55.5 {5.66}			4.2 {0.43}		
48	N {kgf}	57.5 {5.86}			4.7 {0.48}		
50	N {kgf}	58.5 {5.96}			4.9 {0.49}		
54	N {kgf}	60.0 {6.12}			5.0 {0.51}		

() :参考規格 Reference Standard

{ } :参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP			
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 9 OF 17

【7. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(基板表面温度)
(TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)

注記 NOTE :

本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。Please check the surface-mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand, because they may be different by the temperature profile, the solder paste, the atmosphere (Air or Nitrogen) or the type of the boards.

The different conditions may have an influence on the product's performance.

- ・推奨ランド寸法 Recommended Pattern dimension:
SDをご参照下さい。
Refer to the Sales Drawing.
- ・推奨メタルマスク厚さ Recommended Thickness of metal mask
t = 0.08 mm
- ・推奨メタルマスク開口率 Recommended Open aperture ratio of metal mask
80% (大気リフロー時 for atmosphere)

REVISE ON PC ONLY	B	SEE SHEET 1 OF 17	TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
			PS	003	GENERAL	10 OF 17

[8. 取り扱い上の注意事項 INSTRUCTIONS FOR USE]

[嵌合について- For Mating]

嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。(図-1)

その際、リセハウジングとプラグの外壁同士を合わせる様に位置決めした後に押し込み嵌合して下さい。斜めの嵌合になる場合は10°以下の角度でリセハウジングとプラグの外壁同士を軽く当て、位置決めした後に嵌合して下さい。(図-2)

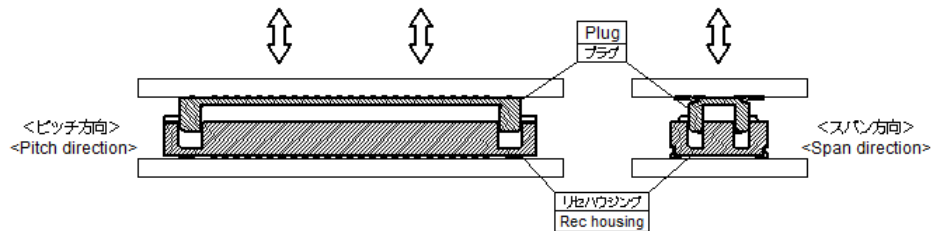
尚、リセハウジング内壁とプラグ内壁とを当てた(支点とした)状態で嵌合を行いますと、反支点側のリセハウジングとプラグの外壁が干渉し、ハウジングが破壊する恐れがありますのでこのような嵌合はお避け下さい。(図-3)

Please mate the connector horizontally along the mating direction shown below. (See figure1)

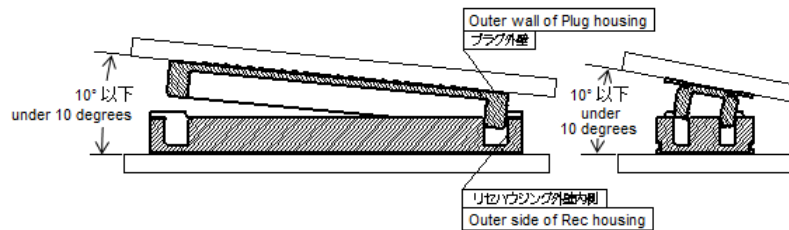
Please correctly position the outside wall of housing of the plug with the inside of the receptacle housing and mate them together.

In case of diagonal mating, please ensure that the leading angle is a maximum of 10 degrees. (See figure 2)

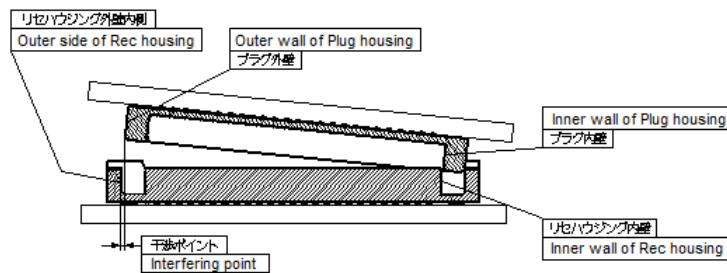
Please avoid mating the connectors and then rotating them when they are in the mated condition because it may damage the housing on the plug or receptacle. (See figure3)



○ 図-1 平行状態での挿抜 (Best)
Figure-1 Horizontal Mating/Unmating (Best)



△ 図-2 外壁合せによる嵌合 (Acceptable)
Figure-2 Mating aligning to outer wall of housings (Acceptable)



× 図-3 内壁合せによる嵌合 (Not Good)
Figure-3 Mating aligning to inner wall of housings (Not Good)

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP		
	REV. DESCRIPTION	PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書		
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
5050660000	PS	003	GENERAL	11 OF 17
EN-127(2015-12)				

[抜去について- For Un-mating]

抜去は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。(図- 1)

または、左右に少しずつ振りながら行ってください。(図- 4)

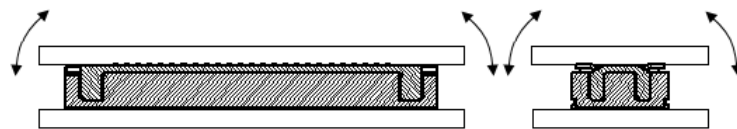
過度のこじり抜去には注意して下さい。過度のこじり抜去ではコネクタが破壊する可能性があります。(図- 5)

Please un-mate the connector horizontally along the mating direction shown below. (See figure 1)

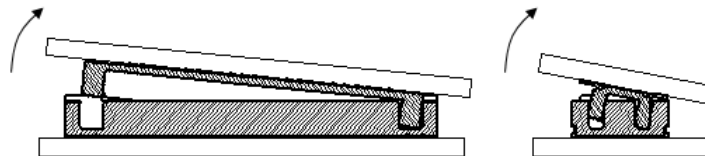
Or please un-mate the connector by lightly shaking it from side to side. (See figure 4)

Please be very careful when un-mating the connector at an angle.

This may cause damage to the connector. (See figure 5)



○ 図-4 抜去 (Best)
Figure-4 Withdrawal



× 図-5 こじり抜去 (Not Good)
Figure-5 Withdrawal with twisting the connector at an angle

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP		
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL
				SHEET 12 OF 17
EN-127(2015-12)				

【9. その他 注意事項 OTHER PRECAUTIONS】

・外観について Appearance

1. 本製品の樹脂部に黒点、多少の傷、微小な気泡等が生じることがありますが、性能上問題ありません。また、本製品のモールド材料は LCP を使用しているため、ウェルドラインが目立つ場合がありますが、製品性能には影響しないものです。
Although this product may have a small black dot, a weld line or a scratch on the housing, it doesn't impact the product's performance. {Also, although weld line may stand out due to LCP used to mold material of this product, it doesn't impact the product's performance.}
2. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。
Although there may be slight differences in the housing color tone, it doesn't impact the product's performance.

・実装について Mounting

3. 本リフロー条件に関しては、実装条件(大気/N2 リフロー、温度プロファイル、半田ペースト、メタルマスク板厚・開口率、基板パターンレイアウト、実装基板種別などの種々の要素)により条件が異なりますので、必ずご使用前に、顧客様のご使用環境で事前に実装評価(リフロー評価)を実施願います。実装条件によっては、接点部への半田上がりやフラックス上りが発生するなど製品性能に影響を及ぼす場合があります。
Please make sure to do test run under the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices before use because reflow condition may change due to the local condition (Air / N2 reflow / temperature profile / solder paste, metal mask thickness / aperture rate / pattern layout of PWB / types of PWB / and other factors). Depending on the mounting condition, product's performance might be influenced by occurrence of solder-wicking or flux wicking at contact area.
4. 本製品の一般性能確認はリジッド基板にて実施しております。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。
The product performance was tested using rigid PWB. In case the product needs to be mounted onto FPC, please conduct a reflow test on the FPC before use.
5. フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。
In case of mounting the connector onto FPC, add a stiffener on the FPC in order to prevent the deformation.
6. 本コネクタを搭載する基板(PWB/FPC)において、過度な温度上昇を避ける為、適切なパターンデザインを行ってください。
Please design appropriate pattern on boards (PWB / FPC) for this connector to avoid excess temperature rise.
7. 弊社の推奨基板パターン寸法を変更して設計を行なう際は、致命的な不良の原因にもなりますので、あらかじめご相談ください。
In case of designing with changing our recommended board pattern size, please consult the contact person in advance because it may cause a fatal defect.
8. 実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mm として下さい。
The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the PWB. Warpage of the PWB should be 0.02mm at maximum at center of the connector based on the both sides of connector.
9. 本製品は大気リフローでの実装を想定しています。N2 リフローで実装した場合、リフロー後、半田上りを生じる恐れがあります。N2 リフローでの実装をお考えの場合、別途評価が必要になります。
This product is designed to be mounted by air reflow. So, if this product is mounted by N2 reflow, solder wicking may caused after reflow. Therefore if it is plan to adopt N2 reflow for this connector, an evaluation is needed separately.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP			
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 13 OF 17
EN-127(2015-12)					

10. 弊社評価では本仕様書記載の推奨条件に基づき評価を実施しています。
Our evaluation is conducted based on Molex-recommended condition specified in this product specification.
11. 本製品の平坦度については、実装前での保証のみであり、実装中および実装後での平坦度については、保証の限りではありません。
Only coplanarity before reflow is guaranteed. Coplanarity in and after reflow is not guaranteed.
12. 本製品は端子先端部に、カット面がある為に端子先端部の実装性(基板への半田付け性)は、端子側面・後側に比べて悪くなります。しかし、側面及び後側においてフィレットが形成されていれば、機能及び強度に問題は
ありません。
The solderability of the terminal tip, which is cut surface without plating, is worse than the sides/back of the terminal with plating. However, it will not impact the product's function or the retention force if good soldering fillet is formed at the sides/back of the terminal.
13. 製品仕様上、テール上面まで半田濡れ上がりはありませんが、製品性能上問題ありません。
Although the top surface of tail does not get wet with solder due to the product specification, it does not impact on the product's performance.
14. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
If you leave any soldering area on this product open, it could occur terminal disengagement, short circuit between pins, terminal buckling or connector disengagement from the PWB. Therefore, please solder all of the soldering tails and fitting nails on the PWB.
15. 本製品は低背の為、端子コンタクト部以外の場所へフラックス上りが発生することがありますが、製品性能には影響ありません。
Since this product is low profile product, flux wicking could be occurred on the areas except for the terminal contacts. However it does not impact on the product's performance.
16. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認下さい。
If accidental contact is added onto connectors in the reflow machine, connectors could be deformed or damaged. Therefore review the reflow machine before use of the connectors.
17. リフロー条件によっては、樹脂部の変色や膨らみ、端子めっき部にヨリが発生する場合がありますが、製品性能に影響はございません。
Although color tone of housing or any deformation on the housing, or surface of terminal plating could be varied depending on reflow conditions, it does not impact on the product's performance.
18. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。
Although some discoloration could be seen on the soldering tail after reflow, it does not impact on the product's performance.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP			
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 14 OF 17
EN-127(2015-12)					

・製品の仕様について Product specification

19. 本製品をご使用時には、1PIN 当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けて下さい。
When using this product, ensure that the specification for rated current per a circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.
20. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。
Do not use the connector in a condition where the mating area (contact area) are constantly moved due to sympathetic vibration of wires and PWB or constant movement of devices. It may cause contact failure due to the worn out. Therefore fix wires and PWB on the chassis to reduces sympathetic vibration.
21. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあげた筐体構造にして下さい。
Keep enough clearance between connector and chassis of your application in order to avoid pressure on the connector.
22. 本製品を結露・水濡れが発生する環境でのご使用の場合は、適切な防滴処置をお願い致します。結露・水濡れにより、回路間で絶縁不良を起こす可能性が御座います。
When using this product in an environment where dew condensation and water wetting occur, apply an appropriate drip-proof treatment. Dew condensation and water wetting could cause insulation failure between the circuits.
23. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
Avoid using a connector alone to mechanically support the PWB. Adopt separate fixture to support PWB besides the connector in the chassis.
24. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られていません。スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないで下さい。
Do not mate and un-mate connectors while those are energized since this connector is not designed to allow it. It may cause danger due to sparks and functional failure of the product.
25. 一枚の基板にコネクタを複数実装する場合は、嵌合相手側はそれぞれ個別の基板に実装してご使用をお願いします。
When mounting several board to board connectors on a same PWB, ensure to mount the each mating connector on a separate PWB.
26. 本製品及び加工工程品(仕掛品)や加工品(ハーネス品)の梱包及び輸送・保管時において、コネクタ間での絡みや衝撃、積み重ね等による負荷が掛からないようにして下さい。変形・破損等による性能不良の原因となります。
At packaging, transportation and storing, avoid applying loads to connectors by handling, interference of connectors or piling-up packages. It could cause functional defect such as connector deformation or breakage.
27. 推奨保管条件での保管をお願い致します。もし、梱包品の推奨保管条件を超えてしまった場合は外観、半田付け性を確認の上ご使用ください。
Store the products under recommended storage condition. If the recommended storage conditions of the packaging is exceeded, check the appearance of the products and solder-wettability before use.
28. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。
Do not stack PWB directly after mounting the connector on it.
29. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。
Do not wash connector because it may impact the product's function.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP		
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL
				SHEET 15 OF 17
EN-127(2015-12)				

・製品操作について Product operation

- 30. 基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。
Do not touch the terminals and fitting nails of connectors before or after mounting onto the PWB.
- 31. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。Avoid move or assembly of connector which could apply loads to the direction of the connector pitch, span or rotation. It may damage the connector and crack the soldering.
- 32.ハウジングのロック部やランス部などの可動部、及び端子を故意に変形させないで下さい。製品性能が満足出来ない原因となります。
Do not purposely deform the movable parts such as housing lock or lance and terminals. It may impact the product performance.
- 33. 嵌合の際、嵌合が不十分にならないようにご注意ください。また、セットへの組み込み後も、振動、衝撃等で嵌合の浮きが発生しないような状態にて使用してください。
Ensure to mate connectors fully. Also mount and assemble the connector in your application unit with disengagement proof to avoid connector disengagement due to vibration or shocks.
- 34. コネクタの詳細な取り扱いにつきましては、別に定めるコネクタ取り扱い説明書(Application Specification)を参照して下さい。
Refer to the Application Specification for details of connector handling instruction.

・リペアについて Repair

- 35. 実装後において半田こてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product specification are not followed, it may cause the terminal disengagement, contact gap change, housing deformation, housing melting, and connector damage.
- 36. 半田こてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, do not use excess solder and flux than needed. It may cause solder wicking and flux wicking issues, and also eventually cause a contact defect and functional issues.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
B	SEE SHEET 1 OF 17	0.35 BB CONN. H=0.6 SSB6 RP			
		PRODUCT SPECIFICATION 製品仕様書			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER 5050660000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 003	CUSTOMER GENERAL	SHEET 16 OF 17
EN-127(2015-12)					

